



## 平成26年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年12月10日

上場取引所 東

上場会社名 サムコ 株式会社

コード番号 6387 URL <http://www.samco.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理統括部長

四半期報告書提出予定日 平成25年12月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 辻 理

(氏名) 竹之内 聰一郎

TEL 075-621-7841

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年7月期第1四半期の業績(平成25年8月1日～平成25年10月31日)

#### (1) 経営成績(累計)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益		
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
26年7月期第1四半期	598	△44.5	△106	—	△100	—	△67	—	
25年7月期第1四半期	1,077	41.3	65	—	86	—	52	—	
1株当たり四半期純利益			潜在株式調整後1株当たり四半期純利益						
26年7月期第1四半期			円 銭	円 銭					
25年7月期第1四半期			△9.64	—					
			7.43	—					

#### (2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
26年7月期第1四半期	8,753		6,647		75.9		945.00	
25年7月期	8,990		6,838		76.1		972.02	

(参考) 自己資本 26年7月期第1四半期 6,647百万円 25年7月期 6,838百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金					合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	円 銭	
25年7月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	18.00	18.00
26年7月期	—	0.00	—	—		
26年7月期(予想)		0.00	—	—	15.00	15.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成26年7月期の業績予想(平成25年8月1日～平成26年7月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
第2四半期(累計)	2,100	16.4	150	317.9	145	△27.7	88	△26.9	12.50	
通期	5,050	20.2	625	82.6	615	9.0	380	7.2	54.02	

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### ※ 注記事項

##### (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、【添付資料】3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(1)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

##### (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更	: 無
② ①以外の会計方針の変更	: 無
③ 会計上の見積りの変更	: 無
④ 修正再表示	: 無

##### (3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年7月期1Q	7,042,881 株	25年7月期	7,042,881 株
② 期末自己株式数	26年7月期1Q	8,056 株	25年7月期	7,996 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年7月期1Q	7,034,840 株	25年7月期1Q	7,035,586 株

#### ※四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、【添付資料】3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	7
第1四半期累計期間	7
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
4. 補足情報	9
(1) 生産、受注及び販売の状況	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、金融緩和や経済対策による円安・株高基調が続き、企業収益の改善や、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、景気は徐々に回復基調を辿りつつあります。世界経済では、米国で個人消費や住宅投資が堅調に推移するなど、引き続き緩やかな回復基調にありました。欧州では景気の下げ止まりが見られたものの、中国における経済成長の鈍化、新興国の景気減速の動きが見られました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレット型端末の世界的な需要拡大を背景に、一部の企業による設備投資は堅調でありました。その一方で、業界全体における設備投資は調整局面から脱却しておらず、アジア市場での生産機への投資につきましても、商談や引き合い等の動きは徐々に上向いていくものの、受注環境の本格回復には至っていない状況であります。

このような状況の下、国内市場は電子部品分野のSAW (Surface Acoustic Wave=弹性表面波) フィルター用途をはじめとする電子部品向け製造装置の販売があったものの、海外市場の生産機の需要回復に至らない中、大口案件が出荷前の端境期であったことも影響し、売上高は低水準に留まる結果となりました。なお、当第1四半期累計期間の受注高は1,179百万円（前年同期比4.9%増）と、受注動向は国内の大口案件を中心に堅調であり、当第1四半期会計期間末の受注残高は1,591百万円（前年同期比62.6%増）となりました。

以上の結果、当第1四半期累計期間における業績は、売上高が598百万円（前年同期比44.5%減）、営業損失が106百万円（前年同期は営業利益65百万円）、経常損失が100百万円（前年同期は経常利益86百万円）、四半期純損失は67百万円（前年同期は四半期純利益52百万円）となりました。

## (品目別売上高)

品目	売上高（千円）	構成比（%）	前年同期比（%）
CVD装置	40,800	6.8	△88.3
エッチング装置	359,457	60.1	△35.2
洗浄装置	37,350	6.3	23.3
その他装置	—	—	—
その他	160,444	26.8	19.0
合計	598,052	100.0	△44.5

## (用途別売上高)

用途	売上高（千円）	構成比（%）	前年同期比（%）
オプトエレクトロニクス分野	123,800	20.7	△82.1
電子部品分野	181,670	30.4	60.4
シリコン分野	104,755	17.5	496.5
実装・表面処理分野	—	—	—
表示デバイス分野	—	—	—
その他分野	27,381	4.6	△76.0
部品・メンテナンス	160,444	26.8	19.0
合計	598,052	100.0	△44.5

## (2) 財政状態に関する説明

## (流動資産)

当第1四半期会計期間末における流動資産の残高は、5,389百万円で前事業年度末に比べ227百万円減少いたしました。仕掛品の増加が247百万円、現金及び預金が217百万円増加した一方、売掛金の回収が進み、売上債権が741百万円減少したのが主な要因であります。

(固定資産)

当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は、3,364百万円で前事業年度末に比べ9百万円減少いたしました。減価償却に伴い有形固定資産が13百万円減少したのが主な要因であります。

(流動負債)

当第1四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,461百万円で前事業年度末に比べ45百万円減少いたしました。仕入高増加に伴い買掛金が162百万円増加した一方、未払法人税等が182百万円、未払消費税等が29百万円減少したのが主な要因であります。

(固定負債)

当第1四半期会計期間末における固定負債の残高は、643百万円で前事業年度末に比べ1百万円減少いたしました。退職給付引当金が7百万円増加した一方、長期借入金が9百万円減少したのが主な要因であります。

(純資産)

当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、6,647百万円で前事業年度末に比べ190百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が194百万円減少したことなどによります。自己資本利益率は75.9%と前事業年度末比0.2ポイント低下いたしました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年7月期の業績予想につきましては、当第1四半期会計期間末の受注残高が1,591百万円（前年同期比62.6%増）となり、受注動向は大口案件を中心に増加傾向にあります。第2四半期以降に関しては、引き合い案件の早期受注獲得、受注済み案件の確実な期中出荷、更なる新製品の拡販を推進し、第2四半期累計期間及び通期業績予想達成へ向け取り組んでおります。

これら足元の受注環境や今後の引き合い状況を勘案した結果、平成25年9月10日に発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想数値に変更はありません。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

## 3. 四半期財務諸表

## (1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

	前事業年度 (平成25年7月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,620,458	3,838,306
受取手形	131,498	193,778
売掛金	1,437,176	633,011
仕掛品	305,202	552,302
原材料及び貯蔵品	80,051	85,878
前払費用	5,827	7,224
繰延税金資産	31,105	65,502
その他	5,993	13,749
貸倒引当金	△156	△82
流動資産合計	5,617,157	5,389,671

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年7月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年10月31日)
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
<b>建物</b>	877,089	877,089
<b>減価償却累計額</b>	△533,591	△540,718
<b>建物（純額）</b>	343,498	336,371
<b>構築物</b>	25,314	25,314
<b>減価償却累計額</b>	△21,893	△22,048
<b>構築物（純額）</b>	3,421	3,266
<b>機械及び装置</b>	553,606	553,606
<b>減価償却累計額</b>	△496,880	△504,817
<b>機械及び装置（純額）</b>	56,725	48,788
<b>車両運搬具</b>	44,427	42,096
<b>減価償却累計額</b>	△38,991	△33,863
<b>車両運搬具（純額）</b>	5,435	8,233
<b>工具、器具及び備品</b>	164,085	163,370
<b>減価償却累計額</b>	△152,164	△152,627
<b>工具、器具及び備品（純額）</b>	11,920	10,743
<b>土地</b>	2,530,836	2,530,836
<b>リース資産</b>	43,558	43,558
<b>減価償却累計額</b>	△10,489	△12,032
<b>リース資産（純額）</b>	33,068	31,525
<b>建設仮勘定</b>	—	1,454
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,984,907</b>	<b>2,971,220</b>
<b>無形固定資産</b>		
<b>特許権</b>	12,348	11,215
<b>電話加入権</b>	2,962	2,962
<b>ソフトウェア</b>	139	124
<b>水道施設利用権</b>	2,675	2,605
<b>リース資産</b>	1,361	1,106
<b>無形固定資産合計</b>	<b>19,487</b>	<b>18,013</b>
<b>投資その他の資産</b>		
<b>投資有価証券</b>	46,260	54,029
<b>関係会社株式</b>	20,080	20,080
<b>出資金</b>	5,000	5,000
<b>繰延税金資産</b>	209,919	207,476
<b>差入保証金</b>	57,755	57,838
<b>保険積立金</b>	29,329	29,330
<b>その他</b>	1,083	1,038
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>369,427</b>	<b>374,794</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,373,822</b>	<b>3,364,028</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,990,979</b>	<b>8,753,700</b>

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年7月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年10月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
買掛金	272,088	434,446
短期借入金	800,000	800,000
1年内返済予定の長期借入金	39,996	39,996
リース債務	7,194	7,050
未払金	73,408	53,380
未払費用	30,916	32,248
未払法人税等	188,000	5,293
未払消費税等	29,737	—
前受金	—	100
預り金	25,008	31,697
賞与引当金	18,600	38,100
役員賞与引当金	4,722	—
製品保証引当金	18,100	16,000
設備関係未払金	—	3,656
<b>流動負債合計</b>	<b>1,507,771</b>	<b>1,461,969</b>
<b>固定負債</b>		
長期借入金	16,685	6,686
リース債務	27,236	25,581
長期未払金	1,361	1,279
退職給付引当金	278,816	286,340
役員退職慰労引当金	321,046	323,899
<b>固定負債合計</b>	<b>645,146</b>	<b>643,786</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,152,917</b>	<b>2,105,756</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>	<b>1,213,787</b>	<b>1,213,787</b>
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>	<b>1,629,587</b>	<b>1,629,587</b>
<b>資本剰余金合計</b>	<b>1,629,587</b>	<b>1,629,587</b>
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>	<b>59,500</b>	<b>59,500</b>
<b>その他利益剰余金</b>		
別途積立金	3,287,000	3,487,000
繰越利益剰余金	648,663	254,167
<b>利益剰余金合計</b>	<b>3,995,163</b>	<b>3,800,667</b>
<b>自己株式</b>		
<b>株主資本合計</b>	<b>6,829,483</b>	<b>6,634,935</b>
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>8,578</b>	<b>13,008</b>
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>8,578</b>	<b>13,008</b>
<b>純資産合計</b>	<b>6,838,061</b>	<b>6,647,943</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>8,990,979</b>	<b>8,753,700</b>

(2) 四半期損益計算書  
(第1四半期累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日)	当第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)
売上高	1,077,142	598,052
売上原価	637,013	319,577
売上総利益	440,129	278,474
販売費及び一般管理費	374,814	385,088
営業利益又は営業損失(△)	65,314	△106,614
営業外収益		
受取利息	344	342
為替差益	22,457	8,310
雑収入	172	253
営業外収益合計	22,974	8,906
営業外費用		
支払利息	2,143	1,783
売上割引	38	1,144
雑損失	0	3
営業外費用合計	2,181	2,931
経常利益又は経常損失(△)	86,107	△100,639
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	86,107	△100,639
法人税等	33,768	△32,771
四半期純利益又は四半期純損失(△)	52,338	△67,868

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 4. 補足情報

## (1) 生産、受注及び販売の状況

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきましては、当社の品目別及び地域別に記載しております。

## ① 生産実績

(単位：千円)

区分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
CVD装置	204,255	20.0	93,054	8.6	699,982	17.7
エッチング装置	594,497	58.0	764,210	70.8	2,440,230	61.6
洗浄装置	86,305	8.4	47,537	4.4	251,441	6.4
その他装置	121	0.0	—	—	121	0.0
その他	139,250	13.6	174,595	16.2	567,570	14.3
合計	1,024,429	100.0	1,079,397	100.0	3,959,346	100.0

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 受注実績

(単位：千円)

区分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日)	
	受注高	受注残	受注高	受注残	受注高	受注残
CVD装置	455,073	455,800	167,400	294,200	672,723	167,600
エッチング装置	481,221	427,573	777,462	1,145,979	2,810,737	727,974
洗浄装置	61,054	44,754	36,689	49,289	240,092	49,950
その他装置	—	—	—	—	—	—
その他	127,502	50,839	197,977	101,970	556,543	64,437
合計	1,124,851	978,966	1,179,530	1,591,439	4,280,097	1,009,961

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ③ 販売実績

(単位：千円)

区分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
CVD装置	349,982	32.5	40,800	6.8	855,832	20.4
エッチング装置	554,551	51.5	359,457	60.1	2,583,666	61.5
洗浄装置	30,300	2.8	37,350	6.3	204,142	4.8
その他装置	7,500	0.7	—	—	7,500	0.2
その他	134,808	12.5	160,444	26.8	550,252	13.1
合計	1,077,142	100.0	598,052	100.0	4,201,393	100.0

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 主な輸出地域、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。

(単位：千円)

区分 (地域別)	前第1四半期累計期間 (自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
アジア	344,179	98.3	252,779	96.9	821,873	89.8
北米	5,924	1.7	7,959	3.1	88,468	9.7
欧州	—	—	—	—	4,360	0.5
その他	—	—	—	—	—	—
輸出販売高合計	350,104 (32.5%)	100.0	260,738 (43.6%)	100.0	914,701 (21.8%)	100.0

(注) ( ) 内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。